

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成 18 年 7 月 13 日 (2006.7.13)

【公開番号】特開 2005-125627 (P2005-125627A)

【公開日】平成 17 年 5 月 19 日 (2005.5.19)

【年通号数】公開・登録公報 2005-019

【出願番号】特願 2003-364193 (P2003-364193)

【国際特許分類】

B 2 9 C 59/04 (2006.01)

B 0 5 D 3/12 (2006.01)

B 0 5 D 7/04 (2006.01)

G 0 2 B 1/10 (2006.01)

B 2 9 L 7/00 (2006.01)

【F I】

B 2 9 C 59/04 Z

B 0 5 D 3/12 C

B 0 5 D 7/04

G 0 2 B 1/10 Z

B 2 9 L 7:00

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 5 月 29 日 (2006.5.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも表面が熱可塑性樹脂層からなり、平滑な表面形状を有する基材の表面に、透明な硬化型樹脂からなり、前記熱可塑性樹脂層の表面よりも表面粗さの粗い、微細な凹凸状の表面形状を有する表面保護層を形成し、硬化させた後、該表面保護層上から熱圧プレス処理を施すことにより、該表面保護層の表面を平滑化させると同時に、該表面保護層と前記熱可塑性樹脂層との界面に、該熱圧プレス処理を施す前の該表面保護層の表面形状をほぼ反転させた微細な凹凸状の界面形状を形成することを特徴とする、表面が平滑な表面保護層の形成方法。

【請求項 2】

前記表面保護層の形成前の前記基材の表面粗さ (J I S B 0 6 0 1 (2 0 0 1)) が、算術平均粗さ R_a が $1.0 \mu m$ 以下、最大高さ粗さ R_z が $10.0 \mu m$ 以下であり、前記熱圧プレス処理の前の表面保護層の表面粗さが、算術平均粗さ R_a が $0.5 \sim 10.0 \mu m$ 、最大高さ粗さ R_z が $2.0 \sim 30.0 \mu m$ であり、前記熱圧プレス処理の後の表面保護層の表面粗さが、算術平均粗さ R_a が $1.0 \mu m$ 以下、最大高さ粗さ R_z が $10.0 \mu m$ 以下であることを特徴とする、請求項 1 に記載の表面が平滑な表面保護層の形成方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 0 9 】

また本発明は、上記方法において、前記表面保護層の形成前の前記基材の表面粗さ（ J I S B 0 6 0 1 (2 0 0 1) ）が、算術平均粗さ R_a が $1.0 \mu m$ 以下、最大高さ粗さ R_z が $10.0 \mu m$ 以下であり、前記熱圧プレス処理の前の表面保護層の表面粗さが、算術平均粗さ R_a が $0.5 \sim 10.0 \mu m$ 、最大高さ粗さ R_z が $2.0 \sim 30.0 \mu m$ であり、前記熱圧プレス処理の後の表面保護層の表面粗さが、算術平均粗さ R_a が $1.0 \mu m$ 以下、最大高さ粗さ R_z が $10.0 \mu m$ 以下であることを特徴とするものである。